

張貼日期: 2022/05/19

# 【資安漏洞預警】Intel修復多項晶片韌體高風險漏洞

- 主旨說明: Intel修復多項晶片韌體高風險漏洞
- 內容說明:
  - 轉發 科學園區資安資訊分享與分析中心 SPISAC-ANA-202205-0008
  - Intel在5月10日出安全更新, 以修補存在於資料中心、工作站、行動裝置等平臺的晶片韌體漏洞。
  - 在所有受影響的產品中, IPU-BIOS存在11項漏洞, 包括輸入驗證不當(CVE-2021-0154)、越界寫入(CVE-2021-0153)、存取控制(CVE-2021-33123)及未捕捉例外(CVE-2021-0190)。Uncaught exception等4項風險等級8.2的漏洞, 後果為造成攻擊者擴張權限或資訊洩露。另5個漏洞則涉及本機權限升級(LPE)風險值在7.4到7.9之間, 分別為CVE-2021-33122、CVE-2021-0189、CVE-2021-33124、CVE-2021-33103、CVE-2021-0159。
- 影響平台: Intel處理器7-10代, 含Rocket Lake及Xeon Scalable伺服器端Core Processor with Hybrid Technology行動處理器。
- 建議措施: 請至Intel Security Center 查看相關修補措施。
- 參考資料:
  1. <https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/default.html>
  2. <https://www.ithome.com.tw/news/150953>

計算機與通訊中心  
網路系統組 敬啟

From:  
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:  
[https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailing:announcement:20220519\\_01](https://net.nthu.edu.tw/netsys/mailing:announcement:20220519_01)

Last update: **2022/05/19 16:48**